

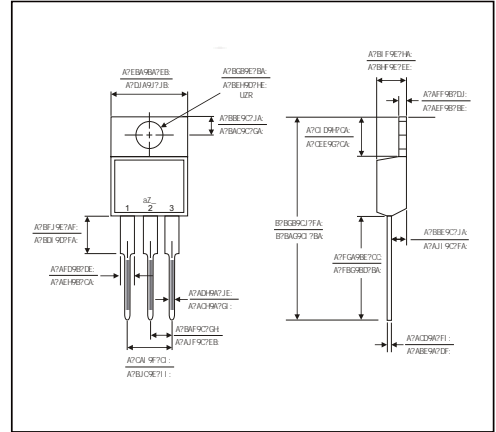
220AB

Features

ÜÖÛÇUPÐÁMHÈÌÀOXÕÙÁMFEXÁÈ  
 Š [ , Á \* æ ^ Á & @ æ : \* ^ Á Ç Á c ^ ] á & æ ] Á J É É Á } Ô ð È  
 Š [ , Á Ô ! • • Á Ç Á c ^ ] á & æ ] Á Í É É Á ] Ø ð È  
 Ø æ • c Á • , á c & @ á } \* Á & æ ] æ à ð ] á c ^ È  
 (É ç æ ] æ ) & @ ^ Á ^ } ^ ! \* ^ Á • ] ^ & á - á ^ Á Á Q { ] ! [ Ç ^ á Á á Ç ð á c Á & æ ] æ à ð ] á c ^ È  
 Þ È Ô @ æ } } ^ Á T U U Ø Ó V

KVUEG Á

Á



Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V <sub>DSS</sub>	600	V
Gate-Source Voltage	V <sub>GSS</sub>	± 30	V
Drain Current - Continuous (T <sub>c</sub> = 25 °C)	I <sub>D</sub>	2.0	A
Continuous (T <sub>c</sub> = 100 °C)		1.26	A
Drain Current - Pulsed * 1	I <sub>DP</sub>	8.0	A
Single Pulsed Avalanche Energy * 2	E <sub>AS</sub>	140	mJ
Avalanche Current * 1	I <sub>AR</sub>	2.0	A
Repetitive Avalanche Energy * 1	E <sub>AR</sub>	4.5	mJ
Peak Diode Recovery dv/dt * 3	dv/dt	4.5	V/ns
Power Dissipation (T <sub>c</sub> = 25 °C)	P <sub>D</sub>	44	W
Derate above 25 °C		0.36	W/ °C
Operating and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	- 55 to + 150	°C
Maximum lead temperature for soldering purposes, 1/8" from case for 5 seconds	T <sub>L</sub>	300	°C
Thermal Resistance, Junction-to-Case	R <sub>θJC</sub>	4	°C/W
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	R <sub>θJA</sub>	54	°C/W

\* 1. Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature.

\* 2. L = 64mH, I<sub>AS</sub> = 2.0A, V<sub>DD</sub> = 50V, R<sub>G</sub> = 25 Ω, Starting T<sub>J</sub> = 25 °C

\* 3. I<sub>SD</sub> ≤ 2.4A, di/dt ≤ 200A/μs, V<sub>DD</sub> ≤ BV<sub>DSS</sub>, Starting T<sub>J</sub> = 25 °C